

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第3区分
 【発行日】令和1年5月9日(2019.5.9)

【公開番号】特開2019-49007(P2019-49007A)
 【公開日】平成31年3月28日(2019.3.28)
 【年通号数】公開・登録公報2019-012
 【出願番号】特願2018-224381(P2018-224381)

【国際特許分類】

C 08 G 59/20 (2006.01)
 C 08 G 59/50 (2006.01)

【F I】

C 08 G 59/20
 C 08 G 59/50

【手続補正書】

【提出日】平成31年3月4日(2019.3.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

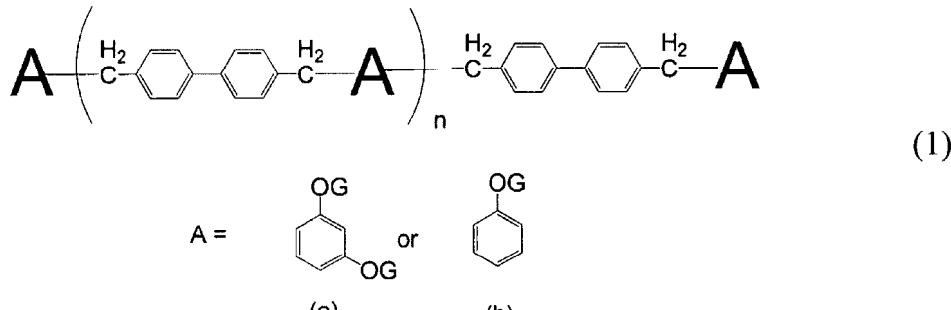
【請求項1】

下記一般式(1)で表されるエポキシ樹脂100重量部に対して、二官能以上のアミン系硬化剤0.2～0.6当量、及び硬化促進剤0.1～5.0重量部を必須成分とするエポキシ樹脂組成物であり、

前記二官能以上のアミン系硬化剤が、アニリンと置換ビフェニル類若しくは置換フェニル類との重縮合により得られるアニリン樹脂であり、

前記硬化促進剤は酸、含硫黄類、イミダゾール類、金属化合物から選ばれる少なくとも1種以上であるエポキシ樹脂組成物。

【化1】



(式中、(a)(b)の比率は(a)/(b)=1～3である。Gはグリシジル基を表す。nは繰り返し数であり、0～5である。)

【請求項2】

請求項1に記載のエポキシ樹脂組成物を繊維基材に含浸してなるプリプレグ。

【請求項3】

前記繊維素材がガラス繊維基材である請求項2に記載のプリプレグ。

【請求項 4】

前記ガラス纖維基材が T ガラス、 S ガラス、 E ガラス、 N E ガラス、 および石英ガラスからなる群から選ばれる少なくとも一種を含む、請求項 2 又は請求項 3 のいずれか一項に記載のプリプレグ。

【請求項 5】

請求項 2 乃至請求項 4 のいずれか一項に記載のプリプレグの少なくとも一方の面に金属箔が積層された、金属張積層板。

【請求項 6】

請求項 1 に記載のエポキシ樹脂組成物からなる絶縁層をフィルム上に、又は金属箔上に形成してなる樹脂シート。

【請求項 7】

請求項 5 に記載の金属張積層板を回路基板に用いてなるプリント配線基板。

【請求項 8】

請求項 2 乃至請求項 4 のいずれか一項に記載のプリプレグ、及び / 又は請求項 6 に記載の樹脂シートを硬化してなるプリント配線基板。

【請求項 9】

請求項 7 又は請求項 8 のいずれか一項に記載のプリント配線基板に半導体素子を搭載してなる半導体装置。